

证券代码：839291

证券简称：利德宝

主办券商：兴业证券

厦门利德宝电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴志敬
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司未来可持续发展的融资需求，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度总计不超过人民币贰仟万元整，授信期限叁年。拟由法定代表人吴志敬、林爱云夫妇和厦门迈拓宝电子有限公司为该授信向银行提供保证担保；公司拟同意将自有的五项专利权作给兴业银行股份有限公司厦门分行提供质押担保，质押担保期限叁年。公司拟授权法人代表吴志敬签署相关合同等法律文件。

专利明细如下：

序号	专利名称	专利号	类型	专利权人	专利状态
1	集成多种功能的一体化铝基板	ZL201710998985.5	发明专利	厦门利德宝电子科技有限公司	专利权维持
2	线路板丝印烘烤工序快速自动化生产系统及方法	ZL201710676306.2			
3	一种可立体化装配电路板及其制备方法	ZL201510674864.6			
4	一种适用于有烘烤需求的PCB自动冲压装置及方法	ZL201710676308.1			
5	一种电路基板的冲切成型方法	ZL201610622587.9			

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司2024年4月3日在全国中小企业股份转让系统发布的《厦门利德宝电子科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于2024年4月18日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议需要提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门利德宝电子科技有限公司第三届董事会第八次会议决议》

厦门利德宝电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日